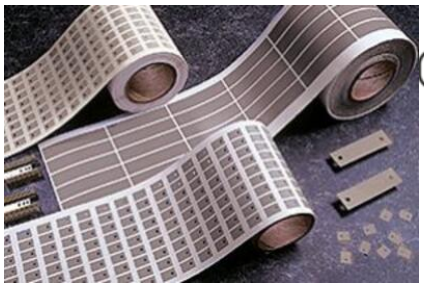
OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

SIL PAD TSP Q2500

Q-Pad®II

SIL PAD TSP Q2500
Aluminum-foil substrate, Silicone based Grease
Replacement for Maximum Heat Transfer



- Lämpöimpedanssi: 0.22°C-in2/W (@50 psi)
- Maksimaalinen lämmönsiirto
- Molemmilta puolilta alumiinifoliolla päällystetty
- Suunniteltu korvaamaan lämpötahna
- Käytetään tilanteissa, joissa sähköneristys ei ole tarpeen

TUOTEKUVAUS

BERGQUIST® SIL PAD TSP Q2500 on yhdistelmä alumiinifoliota, joka on päällystetty termisesti ja sähköisesti johtavalla Sil-Pad -kumilla molemmilta puolilta. Materiaali on suunniteltu tilanteisiin, joissa tarvitaan maksimaalista lämmönsiirtoa eikä sähköneristystä.

BERGQUIST SIL PAD TSP Q2500 on ihanteellinen lämpöliitäntämateriaali, joka korvaa sotkuiset lämpötahnaseokset. BERGQUIST SIL PAD TSP Q2500 poistaa lämpötahnan aiheuttamat ongelmat, kuten juotoksen tai puhdistuksen saastumisen.

Toisin kuin tahnat, BERGQUIST SIL PAD TSP Q2500 voidaan käyttää ennen näitä toimenpiteitä. BERGQUIST SIL PAD TSP Q2500 estää myös pölyn kerääntymisen, mikä voi aiheuttaa mahdollisen pinnan oikosulun tai lämmön kertymisen.